

(0,80mm) .0315"

HSEC8-DV 系列

HSEC8-125-01-L-DV-A

HSEC8-149-01-L-DV-A



垂直 EDGE RATE™ 卡插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?HSEC8-DV

绝缘体材料:

黑色液

晶聚合物

触点:

镀铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 3.1A

(详情参见网站。)

工作温度:

-55°C 至 +125°C

卡插入深度:

(3,15mm) .125" 标称

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (10-60)



配接:

1,6mm 厚度的卡,

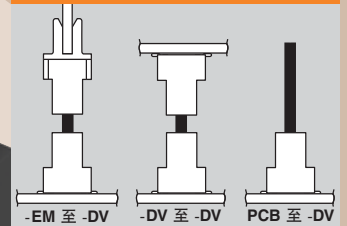
ECDP、HSC8、

HSF8

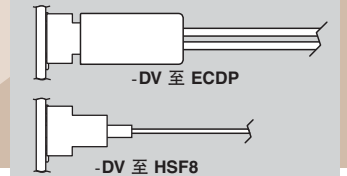


0,80mm HSEC8	在 3dB 插入损耗的额定值
7,98mm 堆叠高度	
单端信号	8 GHz / 16 Gbps
差分对信号	10.5 GHz / 21 Gbps
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?HSEC8-DV 或联系 sig@samtec.com	

板到板应用



高速线缆与柔性应用



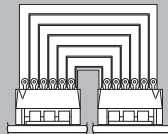
提供标准和定制卡

- 用于 19mm、25mm 和 30mm 配接高度、单端和差分应用的标准高速接口卡。请参见 HSC8 系列。

- 定制卡, 用于低成本堆叠高度定制

- Samtec 提供卡布局/图片以便您制作自己所需的卡

- 特种卡形状



特殊应用选项

导轨和穿过式选项。
请致电 Samtec。

HSEC8	1	每排位置数	卡厚度	电镀选项	DV	A	其他选项
-------	---	-------	-----	------	----	---	------

10, 13, 20, 25, 30, 37,
40, 49, 50, 60

-01
= (1,60mm) .062"
厚度的卡

-03
= (2,36mm) .093"
厚度的卡

-L
= 触点镀 10μ" (0,25μm)
的金, 焊尾镀雾锡

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

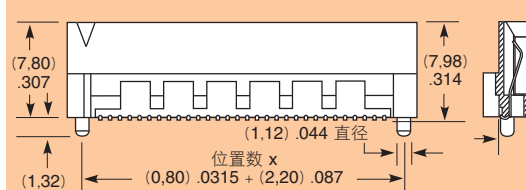
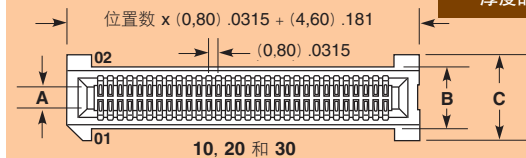
-K
= (5,50mm)
.217" 直径的聚酰亚胺膜
取放垫

-TR
= 卷带封装

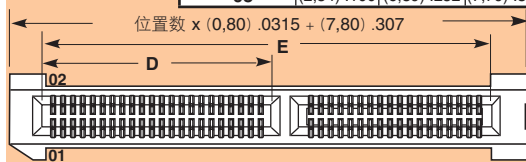
-L1
= 锁定选择
(与 ECDP 一起使用。)
(仅限 13、25、37、49)

-BL
= 板锁
(40, 50, 60 仅限)
(可提供其他尺寸。请联系
Samtec。)

-WT
= 焊接贴片



卡厚度	A	B	C
-01	(1,75) .070	(5,60) .220	(7,00) .276
-03	(2,54) .100	(6,39) .252	(7,79) .307



每排位置数	A	B
13*	(6,10) .240	(15,00) .591
25*	(6,10) .240	(24,60) .969
37*	(18,10) .713	(34,20) 1.346
40	(18,90) .744	(36,60) 1.441
49*	(22,90) .902	(43,80) 1.724
50	(22,90) .902	(44,60) 1.756
60	(26,90) 1.059	(52,60) 2.071
没有给出尺寸的位置没有编码标记。 *与 ECDP 系列配接。		

连接器	线缆*
HSEC8-113	ECDP-08
HSEC8-125	ECDP-16
HSEC8-137	ECDP-24
HSEC8-149	ECDP-32

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM